

半导体新闻周报

汇报时间：2025.11.21

目录

一. 芯联集成发布全新碳化硅G2.0技术平台.....	3
二. 镓未来Gen3平台重磅发布.....	5
三. 三星集团：计划在未来五年内在韩国进行总计450万亿韩元投资 包括扩大半导体投资.....	7
四. 存储器价格攀升冲击消费市场，下修2026年全球智能手机及笔电的生产出货预测.....	9
五. 倒计时2天！魏少军教授主旨报告主题、数据出炉！.....	10
六. Arm与英伟达携手推进定制芯片集成.....	11
七. 台积电CoWoS不再唯一？苹果、高通考虑采用英特尔先进封装技术.....	14
八. 芝奇内存再创新高速！由德国超频好手CENS创下 DDR5-13322超频世界纪录.....	16
九. 格芯宣布收购新加坡硅光子代工厂.....	18
一〇. 赛微电子拟以不超过6000万元购买芯东来部分股权.....	20

①芯联集成发布全新碳化硅G2.0技术平台

2025.11.17

11月16日，**芯联集成电路制造股份有限公司**（以下简称“芯联集成”）正式发布全新碳化硅G2.0技术平台，该平台采用了8英寸更先进制造技术，已达到全球领先水平。

据悉，该技术平台通过器件结构与工艺制程的双重优化，实现“高效率、高功率密度、高可靠”核心目标，全面覆盖电驱与电源两大核心应用场景，可广泛应用新能源汽车主驱、车载电源及AI数据中心电源等广阔市场。

在电驱领域，芯联集成碳化硅G2.0电驱版凭借更低导通损耗与优异开关软度，功率密度提升20%，可显著增强新能源汽车主驱系统动力输出与能效表现，为整车续航提升提供关键支撑。

在电源场景中，芯联集成碳化硅G2.0电源版针对性优化寄生电容设计，通过封装优化强化散热，开关损耗降低高达30%，兼具强化的动态可靠性设计，实现电源转换效率与系统功率密度大幅提升，完美适配SST、HVDC等AI数据中心电源及车载OBC电源需求。



- 芯联集成电路制造股份有限公司
- 成立时间：2018年3月9日
- 官网：<https://cn.unt-c.com/index.html>
- 地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号
- 股东信息：

绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业	16.3%
中芯国际控股有限公司	14.06%
招商银行股份有限公司	3.76%
绍兴硅芯锐企业管理合伙企业	3.26%
绍兴日芯锐企业管理合伙企业	3.06%
中国工商银行股份有限公司	2.9%
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业	1.53%
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	1.46%
富诚海富资管—兴业银行	1.37%
宁波振芯股权投资合伙企业	1.07%



② 镓未来Gen3平台重磅发布

2025. 11. 17

近日，**珠海镓未来科技有限公司** Gen3技术平台650/700V系列场效应晶体管（FET）正式宣布全面推广上市。

镓未来 公司指出，该系列产品将从器件可靠性、效率最大化、应用集成度等方面重新定义功率半导体性能边界，其核心突破将为消费电子、新能源汽车、光伏逆变器等多领域带来革命性的能效跃升。

据悉，Gen3技术平台采用创新栅极设计，实现所有宽禁带器件中最强的栅极鲁棒性，栅极驱动简单且与传统Si MOSFET完全兼容。这一特性使现有产线无需大规模改造即可实现技术升级，显著降低客户导入成本。

Gen3技术平台实现同规格产品最低的反向电压降特性，较行业平均水平降低25%，显著减少续流损耗。在高频开关应用中，这一优势可使整体系统效率提升0.3-0.5个百分点，特别适用于新能源汽车主逆变器和高频DC/DC转换器。

通过引入新工艺设备，Gen3平台成功攻克了老产线的制造桎梏。公司采用更紧凑的互连结构与低延迟栅极优化布线，显著降低了互连部分占地面积。



补充信息—珠海镓未来科技有限公司

- 珠海镓未来科技有限公司
- 成立时间：2020年10月15日
- 地点：武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期B4栋18楼534（自贸区武汉片区）
- 官网：<http://www.ganext.com/>
- 股东信息：

珠海市横琴新区环岛东路3018号2309办公

珠海力创投资咨询合伙企业	25.35335%	582.5395万
北海山旁边投资合伙企业	12.5%	287.2103万
Ga Yacht International Limited	10.12107%	232.55万
珠海恒投投资咨询合伙企业	7.03264%	161.5877万
珠海博泰集成及创业投资基金	5.22439%	120.04万
浙江创智新能源有限公司	4.52833%	104.0467万
珠海睿投资咨询合伙企业	3.97944%	91.4348万
Astrend V(HongKong)Alpha Limited	3.44154%	79.0756万
广州浩瀚投资运营合伙企业	3.02208%	69.4377万
VNTR IX HK Holdings Limited	2.717%	62.4281万



③三星集团：计划在未来五年内在韩国进行总计450万亿韩元投资

2025. 11. 17

近日，三星集团表示，未来五年内将计划总计450万亿韩元（约3100亿美元）的国内投资，包括研发（R&D）。计划扩大半导体投资，在韩国平泽第2工厂新建的第5条线计划于2028年全面投产。三星电子计划通过11月初收购的PlactGroup在韩国建设一条生产线，专注于AI数据中心市场。

三星SDI正在推进在国内建立下一代电池生产基地的计划，例如被称为“梦想电池”的固态电池，并正在考虑将蔚山工厂视为有力的候选者。三星显示器计划从明年开始在忠清南道牙山工厂建设的第8.6代有机发光二极管（有机发光二极管）IT生产设施中正式量产产品。三星已决定在未来五年内雇用60,000名新员工。



- 三星电子 (Samsung Electronics)
 - 成立时间：1969年1月
 - 官网：<https://semiconductor.samsung.cn/>
 - 地址：韩国首尔瑞草区
-
- 三星电子是韩国最大的电子工业企业，同时也是三星集团旗下最大的子公司。
 - 三星半导体在存储器、系统半导体和晶圆代工（Foundry）领域驱动技术革新。三星的存储事业部凭借全球领先的存储半导体技术，加速产业数字化转型；系统LSI事业部为运算处理、通信、电源管理及安全等多种应用设计优化核心芯片；晶圆代工事业部则通过尖端制程技术与深度合作，助力客户实现技术飞跃。



④ 存储器价格攀升冲击消费市场，下修2026年全球智能手机及笔电的生产出货预测

2025. 11. 17

根据TrendForce集邦咨询调查显示，2026年全球市场仍面临不确定性，通胀持续干扰消费市场表现，更关键的是，存储器步入强劲上行周期，导致整机成本上扬，并将迫使终端定价上调，进而冲击消费市场。基于此，TrendForce集邦咨询下修2026年全球智能手机及笔电的生产出货预测，从原先的年增0.1%及1.7%，分别调降至年减2%及2.4%。此外，若存储器供需失衡加剧，或终端售价上调幅度超出预期，生产出货预测仍有进一步下修风险。

从个别产品来看，2025年智能手机存储器价格上扬主要由DRAM带动。2025年第四季 DRAM合约价格对比去年同期上扬逾75%，以存储器占整机BOM cost约10~15%估算，2025年该成本已被垫高8~10%。



⑤倒计时2天 | 魏少军教授主旨报告主题、数据出炉！

2025. 11. 18

ICCAD-Expo 2025（三十一届集成电路设计业展览会）将于2025年11月20日-21日在成都·中国西部国际博览城举行。

作为中国集成电路设计行业的年度盛会，本届展会聚焦产业最新动态、技术趋势与资源对接，是广大半导体人获取权威行业数据与技术方向不可或缺的重要媒介。

魏少军教授将在高峰论坛环节发布2025年中国集成电路设计业现状与发展报告，每年一度的重磅报告是业界了解IC产业销售情况、企业发展情况、主要区域发展情况等权威统计数据的最佳渠道！

此外，十个专题分论坛并行，主题囊括IP、IC设计、EDA、先进封测、Foundry工艺等专题。

资诸多行业知名企业家（其中80%经理级以上，30%总监/VP以上）也将在会上分享最新的集成电路产业技术，以及对产业发展的一手观点。ICCAD-Expo作为中国首要的集成电路行业盛事之一，囊括海内外集成电路领域主要的IC设计厂商，每年吸引着EDA、IP、设计、制造、封装、测试、设备、材料等产业链各环节龙头和代表企业的积极参与。



⑥Arm与英伟达携手推进定制芯片集成

2025. 11. 18

在2025年11月17日，**Arm公司**宣布其基于Arm架构的Neoverse CPU将能通过**英伟达 (Nvidia)**的NVLink Fusion技术，与人工智能（AI）加速器实现高效集成。此举旨在为倾向采用定制化解决方案的客户，尤其是超大规模数据中心（hyperscalers）与云端服务供应商，提供更灵活且高效的AI基础设施选择。

英伟达在AI产业的核心地位持续增强，此次与Arm的合作是其扩展NVLink生态系统的最新举措。英伟达表示，将开放其NVLink平台，允许与多种定制化芯片（包括Arm架构CPU）整合，不再强制客户仅使用自家CPU。

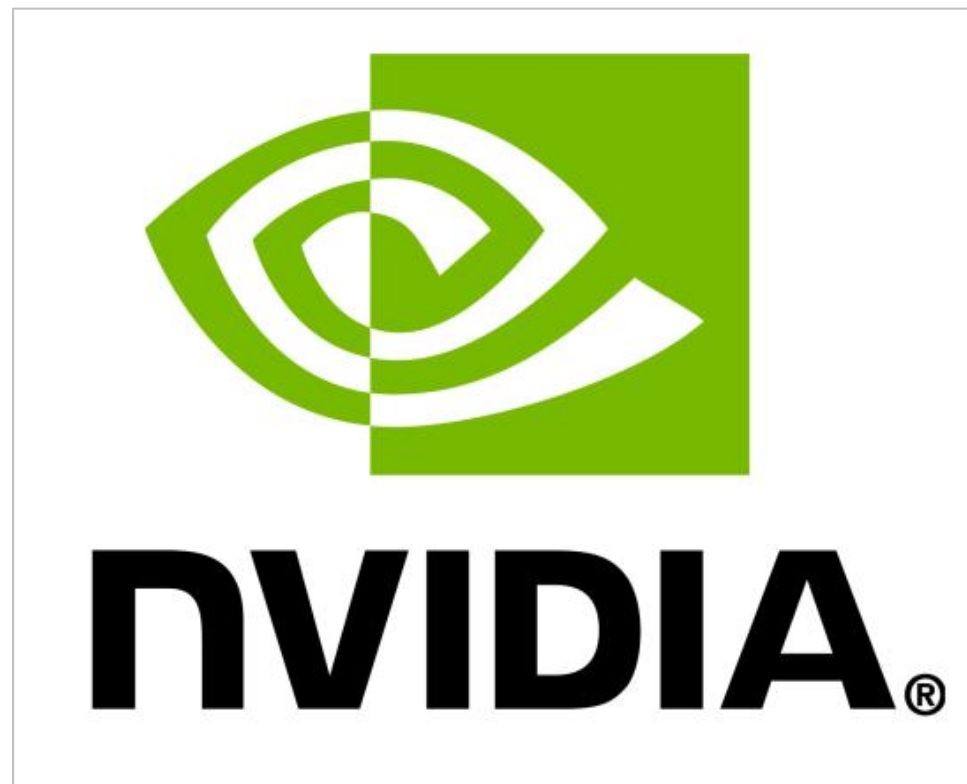
目前，英伟达已推出名为“Grace Blackwell”的人工智能产品，该产品结合多块GPU与一款基于Arm架构的CPU，进一步强化AI服务器的运算能力。



- Advanced RISC Machines
- 成立时间：1990年
- 地点： 英国剑桥
- 官网：<https://www.arm.com/zh-cn/company>
- ARM Holdings 是全球领先的半导体知识产权（IP）提供商，并因此在数字电子产品的开发中处于核心地位。ARM 公司的总部位于英国剑桥，它拥有6000多名员工，在全球设立了多个办事处，其中包括比利时、法国、印度、瑞典和美国的设计中心。ARM公司是苹果、诺基亚、Acorn、VLSI、Technology等公司的合资企业。ARM公司通过出售芯片技术授权，建立起新型的微处理器设计、生产和销售商业模式。ARM将其技术授权给世界上许多著名的半导体、软件和OEM厂商，每个厂商得到的都是一套独一无二的ARM相关技术及服务。利用这种合伙关系，ARM很快成为许多全球性RISC标准的缔造者。



- 英伟达 NVIDIA
- 成立时间：1993年4月5日
- 地点：美国加利福尼亚州圣克拉拉市
- 官网：<https://www.nvidia.cn/>
- 公司早期专注于图形芯片设计业务，随着公司技术与业务发展，已成长作为一家提供全栈计算的人工智能公司，致力于开发CPU、DPU、GPU和AI软件，为建筑工程、金融服务、科学研究、制造业、汽车等领域的计算解决方案提供支持。
- NVIDIA曾获世界人工智能大会的最高奖项“卓越人工智能引领者”。2020年7月，NVIDIA首次在市值上超越英特尔，成为美国市值最高的芯片厂商。2023年5月，成为首家市值达到1万亿美元的芯片企业。



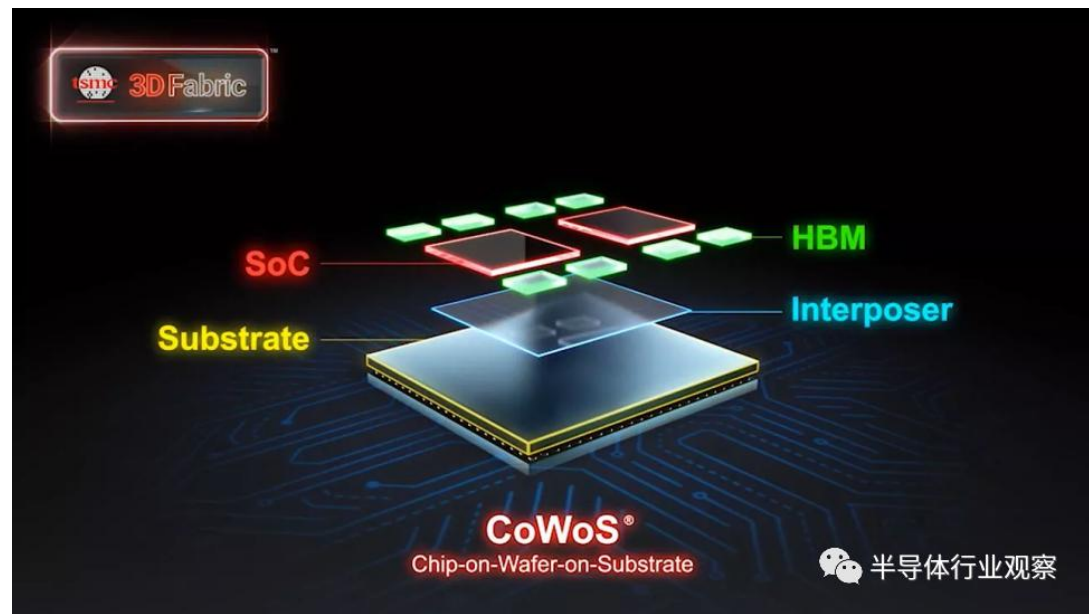
⑦台积电CoWoS不再唯一？苹果、高通考虑采用英特尔先进封装技术

2025. 11. 18

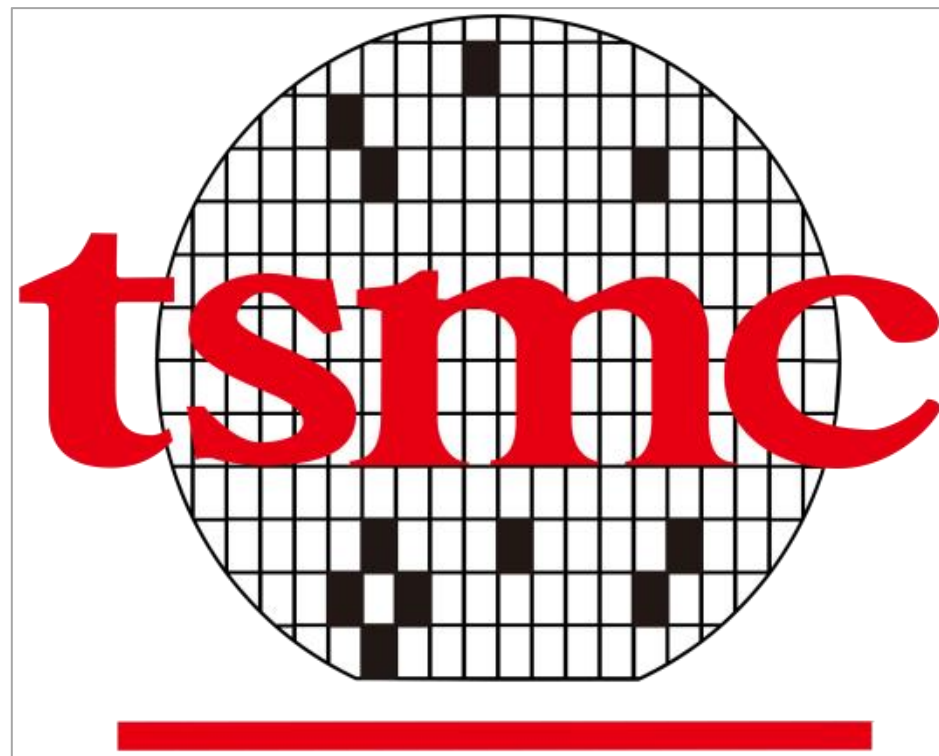
全球先进封装需求持续升温，市场对**台积电CoWoS**产能的依赖也推向高峰。近期外电报道，苹果与高通在新的职缺要求中，明确列出英特尔的EMIB与Foveros等封装技术经验，显示多家大厂正寻求CoWoS以外的替代方案，以应对AI与HPC芯片需求快速成长下的产能瓶颈。

外媒指出，苹果正招聘DRAM封装工程师，要求熟悉CoWoS、EMIB、SoIC与PoP等先进封装技术，而高通数据中心事业部的产品管理主管职缺，也将Intel EMIB列为重要技能之一。

分析认为，由于台积电CoWoS目前主要被英伟达、AMD与大型云端客户承包，新客户的排程弹性有限，使其他芯片大厂开始积极评估多元封装路线。同时，英特尔执行长暨高层此前也多次强调，Foveros与EMIB已取得多家客户的兴趣，并具备量产能力。



- 台湾积体电路制造股份有限公司
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
- 成立时间：1987年2月21日
- 地点：中国台湾省新竹科学园区
- 官网：<https://www.tsmc.com/schinese>
- 台湾积体电路制造股份有限公司（简称台积电、TSMC，与旗下子公司合称台积电集团）是台湾一家专注于半导体芯片制造的高科技跨国企业，总部位于台湾新竹科学园区，是全球前十大企业，也是全球最领先的半导体芯片制造商。其主要业务涵盖芯片制造、封装、测试及技术服务。



⑧芝奇内存再创新高速！由德国超频好手CENS创下 DDR5-13322超频世界纪录

2025. 11. 18

2025年11月18日 - 世界知名的超频内存与高端电竞设备领导品牌，**芝奇国际**今日正式宣布再度打破 DDR5 内存超频世界纪录。此项惊人成就由德国知名极限超频专家 CENS 亲自操刀，成功将内存频率推升至 DDR5-13322，创下全新速度巅峰。本次纪录采用 芝奇 Trident Z5 系列 DDR5 内存 的单根 24GB 模组，并搭配 ASUS ROG Maximus Z890 Apex 主板 及 Intel® Core™ Ultra 9 285K 处理器，透过 LN2 液态氮极限散热与精准内存参数调校，完整展现芝奇内存与最新世代硬件平台的极限潜能，再度缔造崭新的超频里程碑。

芝奇资深内存研发团队持续探索 DDR5 技术的速度极限，并陆续推出具备更强悍效能的超频内存产品，能够与全球用户共同见证顶尖极限超频选手屡次自我突破、刷新纪录，并缔造一系列备受瞩目的卓越成果，深感振奋。本次 DDR5-13322 的突破不仅展现新世代硬件深度协同后所释放的强大效能，也象征电脑高速运算与内存技术的再度跃进。



- G.Skill（芝奇）
- 成立时间：1989年
- 地点：台湾省台北市
- 官网：<https://www.gskill.com/tw/?h=1>
- G.Skill（芝奇）由计算机狂热玩家于1989年创立，总部位于台湾省台北市，专注于超频内存模块及高端电竞外设的研发与生产。其产品以DDR系列内存为核心，覆盖台式机、笔记本及Apple专用内存，并扩展至电竞键盘、耳机、固态硬盘、记忆卡等设备。
- 作为全球超频技术标杆，G.Skill内存采用芯片采购与自主封装模式，从三星、海力士等供应商获取存储芯片，自主完成DIMM模块设计与生产，并结合8层PCB板设计和电镀金工艺，多次助力超频赛事冠军诞生。



⑨格芯宣布收购新加坡硅光子代工厂

2025. 11. 19

近日，美国上市芯片制造商**格芯（GlobalFoundries）**宣布收购位于新加坡的硅光子晶圆代工厂Advanced Micro Foundry（简称“AMF”）。格芯在一份声明中表示，该收购将使其按收入计算成为全球最大的硅光子代工厂。截至目前，该交易的财务条款未予披露。

谈及此次收购原因，格芯首席执行官Tim Breen指出，收购AMF使格芯能够提供更全面、更具差异化的可插拔收发器和共封装光器件发展路线图，同时加速光子技术向汽车和量子计算等相邻市场的发展。

后续布局方面，格芯宣称，将凭借AMF超过15年的制造经验，利用其位于新加坡的200mm平台，满足长距离光通信、计算、激光雷达和传感等领域的需求，并计划随着市场需求的增长扩展至300mm平台。



- 格芯 (GlobalFoundries Inc.)
- 成立时间：2009年3月2日
- 总部地点：美国加利福尼亚州圣克拉拉
- 官网：<https://gf.com/zh/about-us/>
- 该公司最初从超微半导体的制造部门独立而出，目前为世界第五大专业晶圆代工厂，仅次于台积电、三星电子、中芯国际及联电。
- 该公司生产晶圆上的集成电路，主要面向智能移动设备、汽车、航空航天和国防、消费者物联网 (IoT) 以及数据中心和通信基础设施等市场。



⑩赛微电子拟以不超过6000万元购买芯东来部分股权

2025. 11. 19

11月18日晚，**赛微电子**公告称，为进一步完善公司在半导体领域的产业生态布局，公司拟以不超过6000万元交易总价款购买芯东来部分股权。本次交易芯东来估值预计不超过5.20亿元，本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组。

芯东来成立于2023年，是一家具有成熟工艺制程光刻机自研和量产能力的企业，专注于光刻机整机领域，业务分为光刻机再造业务和自研光刻机业务。据公告，交易初步方案为赛微电子拟购买芯东来原股东海南依迈、智能传感产业基金、浔元投资、海创智能装备分别持有的芯东来4.11%、3.00%、2.80%、1.09%股权。

2024年，芯东来实现营业收入7630.46万元，营业利润705.13万元，净利润728.67万元，经营活动产生的现金流量净额-2,062.20万元。2025年1-9月，公司实现营业收入196.31万元，营业利润-1586.74万元，净利润-1579.64万元，经营活动产生的现金流量净额-9968.28万元。



- 北京赛微电子股份有限公司
- 成立时间：2008年05月15日
- 官网：<https://www.smeiic.com/>
- 地址：北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室(德胜园区)
- 股东信息：

杨云春	24.46%
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	8.75%
中金期货有限公司	
—中金期货—融汇1号资产管理计划	0.67%
刘琼	0.67%
国泰君安证券股份有限公司	0.67%
银河德睿资本管理有限公司	0.56%
香港中央结算有限公司	0.54%
招商银行股份有限公司	
—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	0.53%
马鞍山郑蒲港新区综合保税区投资有限公司	0.37%
宋天峰	0.35%



Thank you

🏠 江苏省南京市江宁区双龙大道1698号景枫中心写字楼26楼01室(江宁开发区)

☎ TEL:025-84148808 (09:00-17:30)

✉ E-Mail:info@bosikst.com

@ URL:https://www.bosikst.com